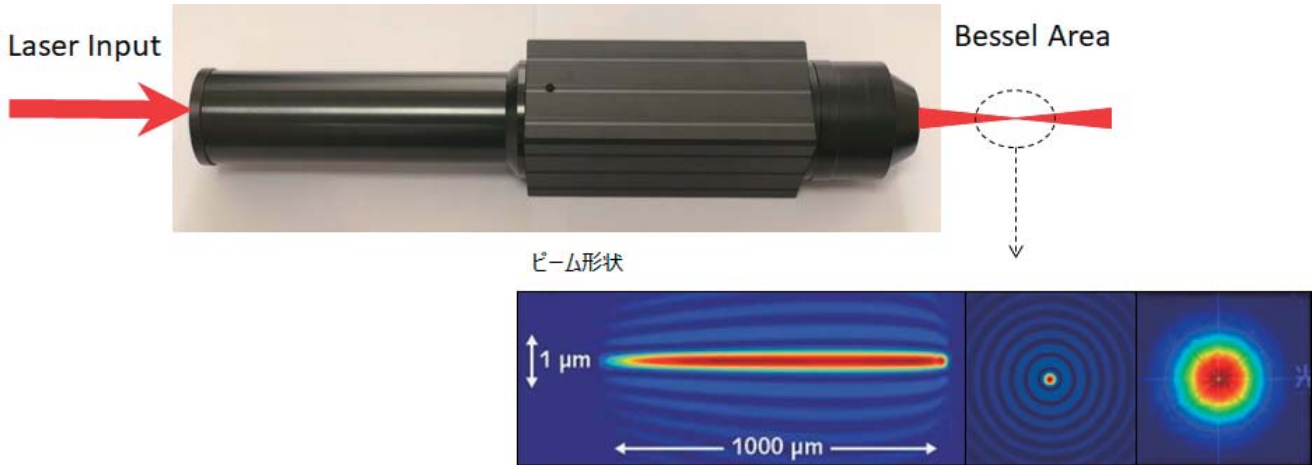


レーザー加工の新提案



ベッセルカッターユニット

0.15mm~5mmの広範囲内で、幅広い焦点深度をご提供

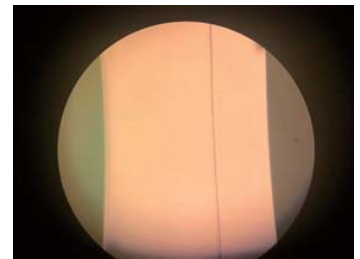


特徴

- ベッセルビームの原理を利用し、レーザー光の集光焦点深度を伸ばす一体加工ヘッドユニット
- 0.15mm~5mmの広範囲内で、幅広い焦点深度をご提供可能
- 加工端面が鏡面に近い効果を実現、簡単にブレーキング可能
- 同軸結像光学系と合わせて使用すれば、精密加工の同時観察が実現可能
- 対応波長 532nm、1064nm

用途

- 全面ディスプレイ携帯カバーガラスの微細加工
- 携帯電話搭載カメラの保護ガラスの切断加工
- サファイア切断加工
- シリコンや液晶パネルの切断加工



ガラス切断面サンプル

仕様

型番	波長	焦点深度DOF	入射ビーム径	作動距離WD
EC-11	1064nm	1.4mm	8mm	8mm
EC-12	532nm	1.4mm	8mm	9mm
EC-21	1064nm	0.4mm	8mm	8mm
EC-22	532nm	0.4mm	8mm	9mm

お客様の用途に合わせたカスタマイズも、お気軽にご相談ください。
 渋谷光学では、大手の光学メーカーでは高額になる特注品の製作も
 リーズナブルな価格と、独自の光学設計でお応えします。